

# 반도체/전기전자

## SOCAMM2 모듈 관련: 총 수요 오히려 증가

반도체/디스플레이

Analyst 김선우  
sunwoo.kim@meritz.co.kr

전기전자/IT 부품

Analyst 양승수  
seungsoo.yang@meritz.co.kr

RA 우서현

seohyun.woo@meritz.co.kr

### [몰이해에 기반한 조정은 기회]

엔비디아 NVL72 탑재 LPDDR5X SOCAMM2 모듈 용량 하락 관련 시장 우려 대두 중 (192Gb → 96GB). 하지만 이는 DRAM 업사이클 내 주가 선행 시 간혹 발생하는 노이즈일뿐, 투자자들은 DRAM 업사이클이 여전히 Mid-cycle에도 미치지 못했음을 명심해야 함. 메모리 투자 비중 축소는 산업 사이클의 어깨부터 시작해야 함은 지속 권고 (현 수준은 사이클의 허벅지 수준)

한편, 시장의 몰이해에 가까운 우려는 오히려 기회로 판단됨. 당사의 대만 및 국내 채널체크에 따르면, 엔비디아는 최근 SOCAMM2 모듈 물량 비율을 변경하며, 전체 주문량을 오히려 증가시킴. 192GB 모듈이 반절로 주는 대신, 96GB 모듈은 오히려 6배에 가깝게 증가하며 주력 제품으로 변경함 (64GB 모듈은 50% 증가). 이는 메모리 공급난 속 Vera Rubin 시스템 판매를 우선 확대하기 위한 엔비디아의 교육지책

이로 인해 총 SOCAMM2 LPDDR 수요량은 기존 전망 대비 10~20% 증가하게 됨. 아울러, Vera Rubin 시스템이 우선 출하된 이후 언제든지 고용량 모듈로 업그레이드가 가능하단 측면에서, 중장기 메모리 수용 여력이 더욱 확대되는 긍정적 이벤트로 해석해야 함. 아울러 기판 등 SOCAMM2 모듈 부품/소재/후공정 업체들의 경우 저용량 제품 출하 확대 변화에 따라 26E/27E 출하량이 폭발적으로 상향조정되리라 예상됨

당사 채널체크에 의하면, 이번 용량 조정에 따른 SOCAMM2 모듈의 부품·소재단 디자인 변경은 없는 것으로 파악됨. 즉, 모듈당 메모리 용량은 낮아지지만 기판 스펙, 주요 소재 구성, 후공정 난이도에는 큰 변화가 없기 때문에 관련 밸류체인 입장에서는 출하량 증가 효과가 그대로 반영될 전망. 오히려 다음 세대 제품에서는 고속 신호 대응과 전력 무결성 확보를 위해 기판 층수 증가, 적층 구조 고도화, 저손실 소재 채택 확대가 예상됨. 따라서 이번 조정은 단기적으로는 SOCAMM2 모듈 출하량 확대, 중장기적으로는 고부가 기판·소재 스펙 상향이라는 이중 수혜로 해석할 필요가 있음

Meritz Research 2026. 6. 5

표1 엔비디아 SOCAMM2 물량 조정 변화폭

메모리	조정폭
192GB	-50%
96GB	+400%
64GB	+50%
<b>전체 물량 (GB)</b>	<b>+10~20% (업체별로 상이)</b>

자료: 메리츠증권 리서치센터

**Compliance Notice**

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에서 해당 추천 종목을 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 추천 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.